

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2022-021

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于拟投资新建鼎龙仙桃光电半导体材料产业园的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为抓住泛半导体材料的市场机遇，丰富公司现有产品及完善产业布局，进一步提升公司在泛半导体核心进口替代类工艺材料产业中综合竞争实力，保证充足的产能并更好服务国内芯片制程客户及柔性显示面板客户需求，公司拟与湖北省仙桃市高新技术产业园签署相关合作协议，拟同意公司（暂定主体，后期可能依项目实施需求及进展情况在公司并表子公司范围内调整实施主体）使用自有或自筹资金在湖北省仙桃市高新技术产业园西流河镇化工产业园建设鼎龙仙桃光电半导体材料产业园（暂定名），具体实施：集成电路CMP用抛光材料产业化及光电半导体柔性显示用关键材料产业化项目。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。

2022年4月13日，公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于拟投资新建鼎龙仙桃光电半导体材料产业园的议案》，并同意授权公司董事长或其授权人士办理后续与项目投资建设相关的事宜。根据《公司章程》及《对外投资及担保管理制度》等相关制度，本次投资金额在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：集成电路CMP用抛光材料产业化及光电半导体柔性显示用关键材料产业化项目

2、实施地点：湖北省仙桃市高新技术产业园西流河镇化工产业园（具体地块位置、界限、面积以自然资源和规划部门批复为准），项目合计用地约 220 亩

3、实施主体：公司及控股子公司

4、资金来源：公司自有或自筹资金

5、建设周期：具体项目建成时间视项目进度而定；预计自开工建设起三年内分二期完成项目建设

6、建设内容计划为：集成电路 CMP 用抛光液年产 2 万吨扩产项目（分两期建设）、集成电路 CMP 用清洗液年产 1 万吨扩产项目、OLED 用 PSPI 年产 1 千吨产业化项目、OLED 封装材料 INK 年产 600 吨产业化项目，以及第三代半导体用研磨粒子、集成电路 CMP 高纯研磨粒子、光电半导体柔性显示用其他关键材料产业化项目。上述项目将根据产业化进展分二期进行。同时，公司将根据各产品的市场需求和竞争力、工艺设备的装置水平以及工业化生产相关资料等方面综合确定各产品的建设规模。（建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。）

7、投资规模：本项目计划分二期建设，总投资金额约为7.5-10亿元人民币，其中：一期建设规模约为5亿元，预计自开工建设起12-18个月内完成；二期建设规模约为2.5-5亿元，预计自开工建设起18-36个月内完成。总投资计划包括：建设工程投资、设备购置及安装投资、铺底流动资金投资等，最终项目投资总额以实际投资为准，将根据项目实际进展情况按需投入。

三、本次投资的目的和对公司的影响

1、本次投资的目的

本项目的实施，有利于公司充分发挥核心技术优势，进一步优化公司产能布局，形成规模化生产能力，丰富公司泛半导体材料品种，以满足更好服务国内芯片制程客户及面板显示材料客户需求。项目达产后，将为公司贡献新的营收及利润增长点，进一步提升公司整体竞争能力和持续盈利能力，促进公司持续、稳定、健康地发展，符合公司战略发展规划。

2、对公司的影响

本次投资符合国家政策以及公司的发展规划，有利于完善公司的产业布局，

能够巩固公司的核心竞争力，有助于公司中长期发展。

本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本项目建设、投产及生产经营尚需一定的时间，预计对公司2022年度经营业绩不构成重大影响，但对公司未来经营将产生积极影响。

四、风险提示及其他说明

1、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。但不会对公司目前经营产生重大影响。目前，公司正在进行上述项目的备案和安评环评等前置相关工作。

2、本次投资涉及的土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

3、公司光电半导体材料项目的技术、工艺要求和市场门槛极高，虽然公司在研发阶段做了各项充足准备，在产业化的过程中仍会存在一定的实施风险，具体项目的实施及推进仍存在一定的投资风险及不确定性。

4、其他说明：公司“鼎龙潜江光电半导体材料产业园”（详见公告2021-005）中：（1）抛光垫三期建设正在按计划推进，预计于2022年夏季完成设备安装，进入设备联动、试生产阶段；（2）年产2000吨一期清洗液产线已在武汉本部工厂完成投产，根据公司未来产能用地规划及相关项目实施需求情况等综合因素考虑，同时，基于仙桃市与公司武汉本部工厂距离较近，可以一定程度降低运输与管理成本，经审慎研究后，公司拟对鼎龙潜江光电半导体材料产业园中年产1万吨集成电路制造清洗液项目的投资计划和投资方式进行调整，公司决定终止潜江产业园的清洗液项目，并调整至仙桃产业园建设，以满足未来的市场需求。

针对上述风险，公司将与仙桃市高新技术产业园及当地相关管理部门积极沟通对接，尽快完成相关手续办理；选调具有丰富工程建设经验的管理骨干组成项目专班，负责工程建设期间管理，严格把控项目建设进度，保障工程进度和质量等措施对风险进行控制。

公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请

广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2022年4月15日